

BST-21503A 150g Pasta de soldadura de alta calidad para LED BGA SMD PGA Venta superior Pasta de soldadura Pasta de flujo

Descripción del producto:

¡¡100 nuevo y de alta calidad!!

El flujo de resina se usa para facilitar la soldadura.

Limpia y previene la oxidación de metales que permite que la soldadura cree enlaces mecánicos y eléctricos fuertes y duraderos.

También actúa como un agente humectante, aumentando el flujo de soldadura y la eficacia del proceso de soldadura.

Perfecto para teléfonos móviles, tarjetas de PC y otras sofisticadas soldaduras electrónicas de flujo a nivel de chip.

Presupuesto:

Producto: BST-21503A

Punto de fusión: 60 °C

Peso: 150 g / pc

PRODUCT DISPLAY



PRODUCT DETAILS



Name: Soldering Paste

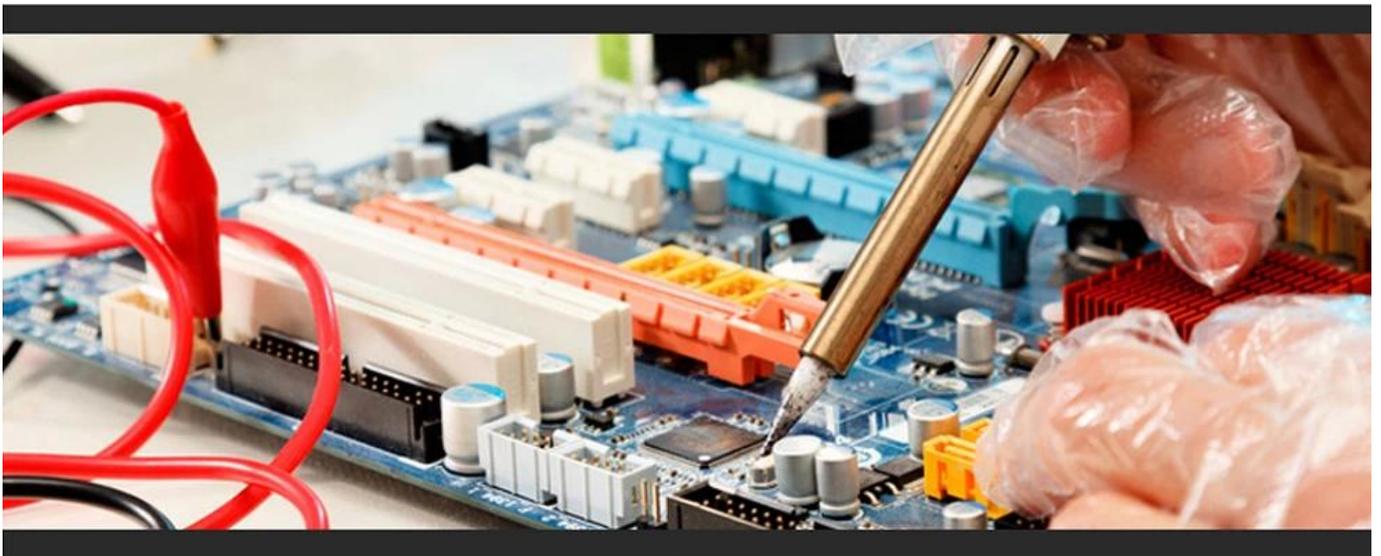
Size: $\Phi 80 \times 45$ mm

Composition: Solder powder, resin

Model: BST-21503A

Weight: 100g

Melting point: 60°C





- ▲ Stable performance, Not volatile, long life cycle, the amount of province;
- ▲ Non-toxic non-irritating odor, the use of safe and reliable;
- ▲ The IC and PCB are not corrosive
- ▲ Its boiling point is only slightly higher than the melting point of solder.

Features: Solder melting at the time of soldering begins to boil endothermic vaporization, which can be maintained at this temperature using IC and PCB temperatures. In the demolition of the chip with a lot of solder paste, it melts fast, you can flow to the BGA chip below. Rosin is solid without solder paste convenient.

PRODUCT PHOTOGRAPH



